

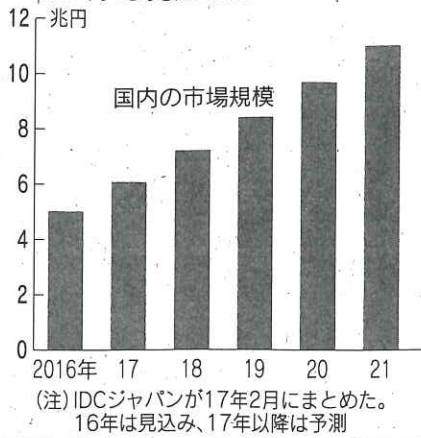
# コネクテックジャパン

## 半導体組み立て能力3倍

半導体受託生産ベンチャーのコネクテックジャパン（妙高市）は半導体の組み立て能力を3倍に引き上げる。低温低圧で半導体を基板に接合する独自の技術を活用し、衣服や化学繊維、樹脂にも装着できるチップを増産する体制を整える。あらゆるモノがネットにつながる「IoT」に対応した製品を手掛け、商機を広げる。

### IoT需要増で設備増強

IoT市場は今後3年で5割以上拡大する見通しだ



## 衣服装着向けチップ増産



従来の5000分の1以下のスペースで半導体の組み立てができる（コネクテックジャパンの工場）

半導体のチップを保護し、動作速度や省エネ性能を高めるパッケージ工程を担う設備を増やす。「デスクトップファクトリー」と呼ばれる装置で、従来の工場に比べて組み立てに必要な面積が5000分の1以下で済む。

妙高市の工場1階にある既存の1ラインに加え、5月に6ラインを2階に設ける。月間500万個の組み立てに対応できる体制を作る。

チップを基板に接合する際には高温高圧をかけるのが通常だが、繊維などに付けて曲げることが

織維のほかポリエチレンテレフタレート（PET）といった樹脂や有機ELへの装着も想定する。「IoTをあらゆる業種で導入する動きに対応する」（平田勝則社長）のが狙いだ。

開発に着手。このほど製造に必要な型を作る基礎技術を確認し、チップの大きさを16分の1に縮小するめどをつけた。4月以降も耐久性などに関する検証を進め、1〜2年後の実用化を目指す。

IoT関連の市場は今後も拡大が予想される分野だ。IT（情報技術）専門調査会社のIDCジャパン（東京・千代田）の調査によると、IoTに関連する国内の市場規模は21年まで年平均で約17%成長し、16年比で2倍以上の11兆円まで膨らむ見通しだ。

できるチップは薄いたる技術開発も進める。今年度からチップの端子を電子機器につなぐ配線の間隔を従来の4分の1で持つため、柔軟性

チップをより小型化する。同社は低温低圧下で組み立てるノウハウを高い製品を生産でき

ある10割（約は100万円分の1）に狭める技術

でもIoT技術を活用して体調を把握するといった研究も進むが、データを取得するためのチップのサイズや固さを理由に導入ができていない産業も多い。コネクテックジャパンは新たな産業分野で企業がIoTに進出する動きに備える。